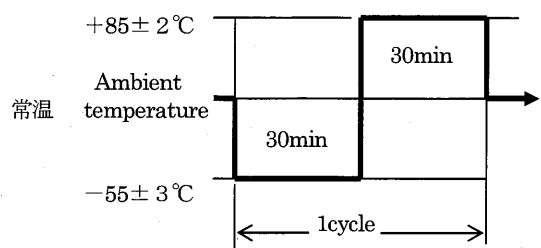


4	挿抜耐久性 Insertion/extraction endurance	ソケットとピンヘッダーを25mm/分の速度で30回繰り返し挿抜を行ない、試験後の接触抵抗を測定する。 The socket and pin header shall be mated and unmated 30 times at the speed of 25mm per minute and measured the contact resistance after the test.	60mΩ以下 60mΩ or below
5	振動試験 Vibration test	コネクタを嵌合した状態にて、振幅1.5mm、振動周波数10~55~10Hz毎分の条件で嵌合軸を含むお互いに直角な3方向に各々2時間計6時間の振動を加える。試験中瞬断の有無を確認する。試験後接触抵抗を測定する。 The connector mated is vibrated in the frequency range of 10~55~10Hz per minute and in the constant vibration amplitude 1.5mm. This motion is applied for period of 6 hours in one of 3 multilateral perpendicular directions (X,Y,Z-axis) included mating axis. It shall be tested the discontinuity of the contact current during the test and measured the contact resistance after the test.	試験中1μs以上の瞬断のない事。 試験後：60mΩ以下 Discontinuity : 1μs or below After the test : 60mΩ or below
6	衝撃試験 Shock test	コネクタを嵌合した状態にて、治具に取付け、加速度490m/s ² 、衝撃作用時間11msをX,Y,Z方向の6面に各3回加える。試験中瞬断の有無の確認及び、試験後接触抵抗を測定する。 The connector mated are installed in the machine. They are applied pulses 3 times to each 6 faces of 3 multilateral perpendicular directions(X,Y,Z); in conditions as specified; acceleration of 490m/s ² and shock pulses for a duration of 11ms. It shall be tested the discontinuity of the contact current during the test and measured the contact resistance after the test.	試験中1μs以上の瞬断の無いこと 試験後：60mΩ以下 Discontinuity : 1μs or below After the test : 60mΩ or below

5-3.環境特性

5-3.Environmental performance

No.	項目/Items	条件/Test conditions	規格/specifications
1	耐熱性 Heat resistance	コネクタを嵌合した状態にて、温度105±2℃の雰囲気中に96時間放置し、放置後接触抵抗を測定する。 The connector mated is exposed in the heat chamber 105±2℃ for 96 hours. It shall be measured the contact resistance after the test.	60mΩ以下 60mΩ or below
2	耐湿性 Humidity	コネクタを嵌合した状態にて、温度60±2℃、相対湿度90~95%RHの雰囲気中に96時間放置し、放置後接触抵抗を測定する。 The connector mated is exposed in the humidity chamber 60±2℃, 90~95%RH for 96 hours. It shall be measured the contact resistance after the test.	60mΩ以下 60mΩ or below
3	塩水噴霧試験 Salt spray test	コネクタを嵌合した状態にて、槽内温度35±2℃、濃度5±1%の塩水噴霧中に48時間放置し、放置後水洗、乾燥し接触抵抗を測定する。 The connector mated is exposed in the salt spray chamber 35±2℃, 5±1% salt density for 48 hours. It shall be measured the contact resistance after the test.	60mΩ以下 60mΩ or below
4	SO ₂ ガス試験 SO ₂ gas test	コネクタを嵌合した状態にて、温度40±2℃、相対湿度75%、濃度10±3ppmの雰囲気中に96時間放置し、放置後接触抵抗を測定する。 The connector mated is exposed in the SO ₂ gas chamber 40±2℃, 75%RH 10±3ppm for 96 hours. It shall be measured the contact resistance after the test.	60mΩ以下 60mΩ or below
5	H ₂ Sガス試験 H ₂ S gas test	コネクタを嵌合した状態にて、温度40±2℃、相対湿度75%、濃度3±1ppmの雰囲気中に96時間放置し、放置後接触抵抗を測定する。 The connector mated is exposed in the H ₂ S gas chamber 40±2℃, 75%RH 3±1ppm for 96 hours. It shall be measured the contact resistance after the test.	60mΩ以下 60mΩ or below
6	冷熱衝撃試験 Thermal shock test	コネクタを嵌合した状態にて下図の温度条件を1サイクルとして10サイクル実施し、試験後接触抵抗を測定する。 The connector mated is exposed 10 cycles in the following temperature. It shall be measured the contact resistance after the test.	60mΩ以下 60mΩ or below



No.	項目/Items	条件/Test conditions	規格/specifications
7	温湿度サイクル試験 Humidity Resistance (cycling)	コネクタを嵌合した状態で下図の温湿度条件を1サイクルとして10サイクル実施し、試験後接触抵抗を測定する。 The connector mated is exposed 10 cycles in the following conditions. It shall be measured the contact resistance after the test. 	60mΩ以下 60mΩ or below

5-4. その他の特性

5-4. Other performance

No.	項目/Items	条件/Test conditions	規格/specifications
1	半田付け性 Solderability	コネクタの半田付け部をフラックスに浸漬した後、245±5°CのSn-Ag-Cu系の鉛フリー槽に3±0.5秒浸す。 The terminal of connector shall be put into the flux and dipped into Pb free solder bath (Type of Sn-Ag-Cu) 245±5°C, 3±0.5s.	浸した面積の95%以上に半田がむらなく付着する事。 Solder shall be covered 95% or more of the area that is dipped into the solder bath.
2	半田耐熱性 Resistance to soldering heat	下記条件にて、半田耐熱試験を行う。 The connector shall be tested resistance to soldering heat in the following conditions. (1) リフロー部品の場合 / In case of Reflow product 240°C MAX (ピーク温度) (Peak temperature) (予熱 150~180°C) (pre-heat : from 150 to 180°C) 温度は製品上面の温度とする。 The temperature shall be measured on the surface of the product. (2) 手半田の場合 / In case of manual soldering. 半田温度 / temperature : 350±5°C 浸漬時間 / time : 3±0.5s 基板厚 / thickness : t=1.6mm (3) ディップ部品の場合 / In case of Dip product. 半田槽温度 / temperature : 260±5°C 時間 / time : 5±0.5s 基板厚 / thickness : t=1.6mm	端子のガタ、割れ等異常のない事。 Should not have any flaw, scratch and crack.

6. その他

本コネクタは、一方の基板を基準として、他方の基板に対して X、Y、Z 各方向に±0.5mm迄基板のズレの吸収が可能です。

6. Postscript

This connector is possible to shift until ±0.5 mm each on X,Y,Z axis when socket (female) and pin header (male) is mating.

